

形XH8

0.8mmピッチSMTコネクタ(スタッキング接続用)

用語解説 A-16

共通の注意事項 A-20

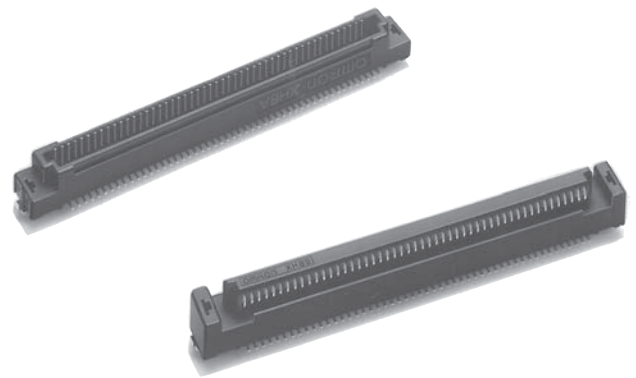
規格認証一覧 後-6

CSM_XH8_DS_J_1_2

情報通信関連機器など、 電子機器の小型化高密度化に対する 0.8mmピッチSMTコネクタ

- コンタクトピッチ0.8mmSMT端子のため高密度実装が可能。
- 自動実装対応可能な吸着面を確保。
- 高耐熱性樹脂の採用により、はんだリフローに対応。
- こじりに強いハウジング構造とベローズ型コンタクトの採用。

RoHS適合 (詳細は、後-33ページをご覧ください。)



X
H
8

■用語の説明

●SMT

Surface Mount Technologyの略。表面実装技術の意。

●ベローズ型コンタクト

薄板を曲げて成形したコンタクト。切断面ではなく、板のロール面が接触するため信頼性が高いのが特長。

”ベローズ”は英語で”蛇の腹”の意。コンタクト構造が”蛇の腹”に似ていることから俗称としてこう呼ばれる。

■定格／性能

| | |
|--------|--------------------------|
| 定格電流 | 0.5A |
| 接触抵抗 * | 60mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V/1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×0.7N以上 |
| 総合抜去力 | 極数×0.085N以上 |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | -55～+105℃(低温にて氷結しないこと) |

*形XH8A-□□35と形XH8B-□□35-2の組み合わせの場合。

■材質／処理

| 項目 | 分類 | プラグ | ソケット |
|--------|-----|-----------------------|------|
| ハウジング | | ガラス入りLCP樹脂(UL94-0)/黒色 | |
| コンタクト | 接触部 | 銅合金/ニッケル下地 金メッキ | |
| | 端子部 | 銅合金/ニッケル下地 金メッキ | |
| ホールド金具 | | 銅合金/錫メッキ | |

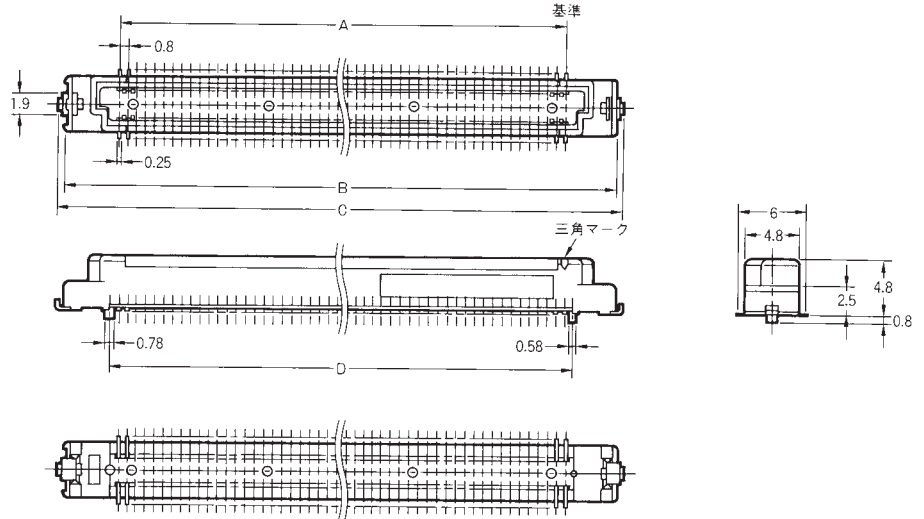
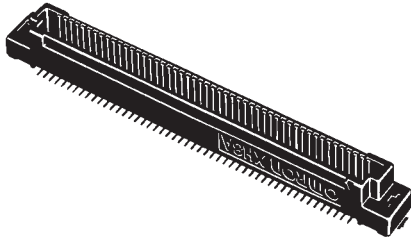
形XH8A プラグ、SMT端子

■外形寸法

(単位: mm)

X
H
8
A

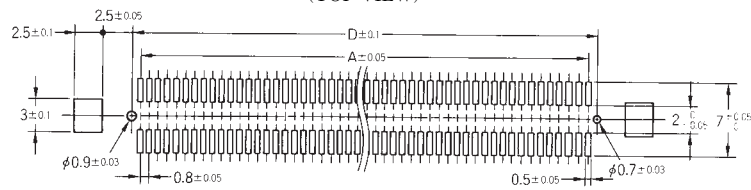
形XH8A-□□35-□



プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)

寸法表

| 寸法 (mm) | A | B | C | D |
|---------|------|------|------|------|
| 極数 | | | | |
| 80 | 31.2 | 40.6 | 41.8 | 32.7 |
| 100 | 39.2 | 48.6 | 49.8 | 40.7 |
| 200 | 79.2 | 88.6 | 89.8 | 80.7 |



■種類

(納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

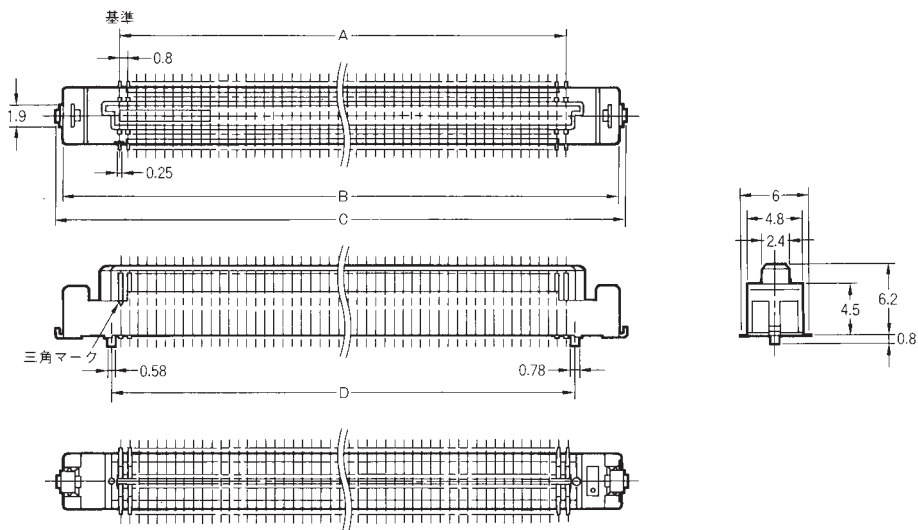
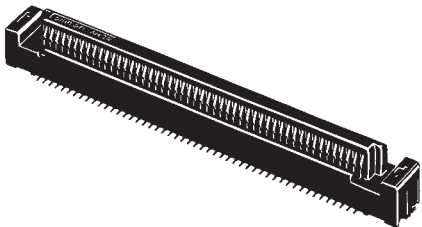
| 形状 | 極数 | 種類 |
|----|-----|------------|
| | 80 | 形XH8A-8035 |
| | 100 | 形XH8A-0135 |
| | 200 | 形XH8A-A035 |

形XH8B ソケット、SMT端子

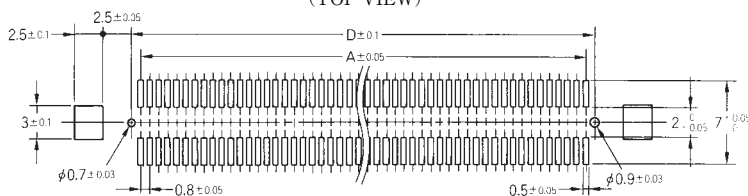
■外形寸法

(単位:mm)

形XH8B-□□35-□



プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)



寸法表

| 寸法(mm) 極数 | A | B | C | D |
|--------------|------|------|------|------|
| 80 | 31.2 | 40.6 | 41.8 | 32.7 |
| 100 | 39.2 | 48.6 | 49.8 | 40.7 |
| 200 | 79.2 | 88.6 | 89.8 | 80.7 |

■種類

(納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

| 極数 | 形状 |
|-----|--------------|
| | |
| 80 | 形XH8B-8035-2 |
| 100 | 形XH8B-0135-2 |
| 200 | 形XH8B-A035-2 |

■かん合図

(単位:mm)

| | |
|----------|-----|
| スタッキング高さ | 8mm |
| かん合図 | |

■端子番号

| 項目 プラグ/ソケット | コネクタかん合面 | プリント基板加工図(TOP VIEW) |
|----------------|----------|---------------------|
| プラグ | | |
| ソケット | | |

- コネクタに端子番号は表示されていません。三角マーク(▼)を基準にしてプリント基板の設計を行ってください。
- 接触の番号をコネクタのかん合面の三角マーク側をa列、三角マーク反対側をb列とし、三角マーク側からそれぞれa1、a2、……、b1、b2、……とすると、上表のようにプリント基板加工図(TOP VIEW)のa1、a2、……、b1、b2、……に対応します。

- プラグとソケットの三角マークは、かん合させると一致します。すなわちプラグとソケットのa1、a2、……、b1、b2、……が接続します。

■正しくお使いください

使用上の注意

●はんだづけ条件について

推奨リフロー条件

予熱過熱温度 150±10℃

時間 60~120秒

はんだづけ温度 200~240℃

時間 30秒以内

(MAX値240℃の時 10秒以内)

●はんだ印刷時のスクリーンの厚さ

クリームはんだ印刷時のスクリーン厚さは、0.15mmを推奨します。

●端子変形について

過渡的な負荷が端子に加わると変形を起こし、実装時にはんだづけ性が劣りますので、製品の落下や乱雑な取り扱いをさけてください。また、基板への実装していない状態でのコネクタの挿抜は行わないでください。端子変形の原因となります。

●リフロー後、自動はんだ槽によりはんだづけを行う場合

フラックス上がりを防止するため基板の位置決めボス穴をテープでマスキングしてから自動はんだを行ってください。